(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特**開2004-7739**4 (P2004-77394A)

(43) 公開日 平成16年3月11日(2004.3.11)

(51) Int.C1. ⁷		FI				テーマコート	* (参考)
GO 1 N	27/333	GO1N	27/30	331M			
GO 1 N	27/30	GO1N	27/30	В			
		GO1N	27/30	331A			
		GO1N	27/30	331Z			
		GO1N	27/30	331F			
		審査請求	未請求 請	求項の数 8	OL	(全9頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	÷	特願2002-241068 (P2002-241068)	(71) 出願ノ	人 59225452	6		
(22) 出願日		平成14年8月21日 (2002.8.21)		学校法人	五島育	英会	a
				東京都渋	谷区道。 -	玄坂1丁目1	0番7号
			(74)代理/	人 10009540	7		
				弁理士	木村	満	
			(72)発明す 	者 秋谷 昌	宏		-
				東京都世	田谷区	玉堤1-28	-1 武蔵工
				業大学内			

(54) 【発明の名称】 バイオセンサ

(19) 日本国特許庁(JP)

(57)【要約】

【課題】高感度、高速応答で、均質性を有し安価なバイ オセンサを提供する。

【解決手段】味覚センサは、ガラス基板などの絶縁基板 11と、該絶縁基板上に直接で形成されたチタン等の金 属電極13と、金属電極13上に形成されたLB膜から なる感応膜17と、から構成される。金属電極は、真空 蒸着法、スパッタリング等のPVD、CVD、MOCV D、メッキなどの方法で、絶縁基板上に直接形成される 。金属膜13の表面粗さは、感応膜を構成するLB膜の 分子間隔と等しいかより小さい。 【選択図】 図1



(2) 【特許請求の範囲】 【請求項1】 絶縁基板と、該絶縁基板上に薄膜堆積法で形成された金属電極と、該金属電極上に形成さ れた感応膜と、を備えるバイオセンサ。 【請求項2】 前記薄膜堆積法は、真空蒸着法、スパッタリング、有機金属化学的気相成長法のいずれか を含む、ことを特徴とする請求項1に記載のバイオセンサ。 【請求項3】 絶縁基板と、該絶縁基板上に電気メッキで作成された金属電極、該金属電極上に形成され た感応膜と、を備えるバイオセンサ。 【請求項4】 前記金属電極は、1nm乃至100µmの厚さを有することを特徴とする請求項1乃至3 のいずれか1項に記載のバイオセンサ。 【請求項5】 前記金属電極は、10nm以下の平坦性を有することを特徴とする請求項1乃至4のいず れか1項に記載のバイオセンサ。 【請求項6】 前記金属電極の平坦性は、前記感応膜を構成する分子の分子間隔と等しいか、より小さい 、ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のバイオセンサ。 【請求項7】 前記感応膜は、ラングミューア・ブロジェット法を用いて作られた膜から構成されている 、ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のバイオセンサ。 【請求項8】 前記金属電極はチタンを含み、前記感応膜は、Di Octadecyldimethy Ammonium Bromideを含む、ことを特徴とする請求項1乃至7のいず れか1項に記載のバイオセンサ。 【発明の詳細な説明】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 【発明の属する技術分野】 本発明は、味覚センサ、臭いセンサなどの化学センサ或いはバイオセンサに関する。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 【従来の技術】 従来、化学センサとして、PH(ペーハ)センサ、イオンセンサ、酵素センサなどが知ら れている。これらは高選択性であるが、多数の物質で構成された味覚や臭覚に対して広範 にわたり十分な感度を得ることは難しい。 これに対し、LB膜(ラングミューア・ブロジェット法を用いて作られた膜)や人工脂質 膜などを用いた味覚センサは、化学センサに比べれば選択性は低いが種々の味覚に対し応 答を示す。特に、LB膜は単分子膜を常温、常圧の環境下で高い秩序で配列、配向制御が 可能であり、人体の舌の構造に類似しているため、センサの膜物質として有望視されてい る。LB膜に用いられる有機膜としては、種々のものが考えられるが、単体の膜で広範囲 の味覚に同程度に感度良く応答を示すものは現在のところ存在しない。そこで、限られた 味 覚 の 範 囲 で 感 度 の 良 い 特 性 を 示 す い く つ か の L B 膜 を 組 み 合 わ せ て 広 い 範 囲 の 味 覚 の 認 識を得る方法が最適である。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 図7は、従来のLB膜を用いた味覚センサの構造を示す。 図示するように、絶縁性の基板1の上には、センサを構成する電極3が配置されている。 電 極 3 の 上 に は 、 L B 膜 4 が 堆 積 さ れ て い る 。 エ ポ キ シ 樹 脂 な ど の 絶 縁 性 樹 脂 5 で 電 極 3 と基板1とが固着され且つ電気的に分離されている。また、電極3からは、リード線6が 引き出されている。

1

[0004]

20

10

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】 味覚センサの電極3の材質としては、感度の観点から、主に金、銀、白金、パラジウムな どの貴金属、特に、銀又は塩化銀が使用されている。しかし、貴金属は、他の金属に比べ て高価であり、センサ自体の価格を上昇させるという問題がある。 貴金属のなかでも、電極として最も特性に優れた銀は、他の金属に比べて加工が困難であ る。このため、従来、味覚センサを構成するために1mm程度の厚さの銀板を用意し、こ れを基板1に絶縁性樹脂5などで貼り付けている。しかし、このような構成の味覚センサ は量産に適しておらず、また、加工精度が低く、素子間で性能のばらつきが大きいという 問題がある。 [0005] 10 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、本発明の第1の観点に係るバイオセンサは、絶縁基板と、該絶 縁基板上に薄膜堆積法で形成された金属電極と、該金属電極上に形成された感応膜と、を 備える。上記の薄膜堆積法は、真空蒸着法、スパッタリング、有機金属化学的気相成長法 等である。 [0006]上記目的を達成するため、本発明の第2の観点に係るバイオセンサは、絶縁基板と、該絶 縁基板上に電気メッキで作成された金属電極、該金属電極上に形成された感応膜と、を備 える。 [0007]20 上述の金属電極は、例えば、1nm乃至100umの厚さを有する。また、10nm以下 の平坦性を有することが望ましい。 [0008]前記金属電極の平坦性は、前記感応膜を構成する分子の分子間隔と等しいか、より小さい ことが望ましい。 [0009]前記感応膜は、例えば、LB膜(ラングミューア・ブロジェット法を用いて作られた膜) から構成される。 [0010]例えば、前記金属電極はチタンから構成され、前記感応膜は、Di Octadecyl 30 dimethyl Ammonium Bromideから構成される。 [0011]【発明の実施の形態】 以下、本発明の実施の形態に係るバイオセンサを、バイオミメティックセンサの一種であ る味覚センサを例に図面を参照して説明する。 図1(a)と(b)は、この発明の実施の形態に係る味覚センサの正面図と側面図である 図1(a)、(b)に示すように、味覚センサは、絶縁基板11と、該絶縁基板11上に 直接形成された金属電極13及び引出電極15と、金属電極13上に配置されたLB膜1 40 7とから構成されている。 絶 縁 基 板 1 1 は 、 ガ ラ ス 基 板 又 は 高 抵 抗 シ リ コ ン 基 板 か ら 構 成 さ れ る 。 [0014]金属電極13及び引出電極15とは、チタン(Ti)、クロム(Cr)等の高融点金属、 金(Au)、白金(Pt)等の貴金属、アルミニウム(A1)、銅(Cu)等から構成さ れ、薄膜堆積法、具体的には、真空蒸着などのPVD(Physical Vapor Deposition)により堆積・形成されている。金属電極13は、例えば、縦横5 ~ 1 0 m m 、 厚 さ 1 n m ~ 1 0 0 μ m 程 度 の サ イ ズ で 、 そ の 表 面 の 粗 さ (金 属 電 極 1 3 の 表面の凸凹のピーク間隔)は、図2に拡大して示すように、10nm以下に設定されてい

50

(4)

る。 [0015] LB膜(Langmuir-Blodgett film)17は、ラングミューア・ブ ロジェット法を用いて作られた、単分子膜を配向配置させた膜であり、分子間隔が10n m程度の分子構造を有する。図2に拡大して模式的に示すように、金属電極13の表面の 平均粗さは、LB膜17の分子間隔と等しいかより小さい値を有する。 [0016]次に、上記構成の味覚センサの製造方法を説明する。 まず、複数の絶縁基板11を形成可能なサイズの原板を用意する。この原板の表面粗さは 、最終的に要求される金属電極13の表面粗さよりも小さい10nm程度以下が望ましい 続いて、図3(a)に示すような、金属電極13及び引出電極15に対応する開口114 がマトリクス状に形成されたマスク113を、図3(b)に示すように原板111上に載 置する。 [0018]次に、前述の高融点金属、アルミニウム(A1)、貴金属等の蒸発源115を備える真空 蒸着装置のチャンバ119内に、図3(c)に示すように、マスク113が装着された原 板111をセットする。続いて、減圧下で、蒸発源115をヒータ117により加熱・蒸 発させ、 蒸 発 源 1 1 5 から 蒸 発 した 金 属 を 原 板 1 1 1 上 に 1 μ m 程 度 付 着 ・堆 積 さ せ 、 マ トリクス状に配置された金属電極13と引出電極15とを形成する。 [0019]次に、Langmuir-Blodgett film(LB)法により、水面などに展 開された単分子膜をマトリクス状に形成された各金属電極13上に、所定層数移し取るこ とにより、マトリクス状に形成された金属電極13それぞれの上に、LB膜17を一括し て堆積する。 次に、原板111を、各絶縁基板11に切り出して、個々の味覚センサを完成する。 [0020]この製造方法によれば、真空蒸着法により、高品質で、表面が平坦で且つ薄い金属電極1 3 及び引出電極 1 5 とを絶縁基板 1 1 上に直接形成することができる。このため、金属電 極13とLB膜17との間の親和性に優れ、感度(最大膜電位と応答速度)の良好な味覚 センサを製造することが可能である。また、金属電極13の材料として貴金属を使用する 場合でも、従来に比して薄い膜が形成可能であり、電極13のコストを抑え、ひいては、 センサ全体のコストを抑えることが可能となる。さらに、1回の製造プロセスで、原板に 複数の味覚センサを形成することができる。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (第2の実施の形態) 前記第1の実施の形態においては、薄膜堆積法により金属電極13を製造するためのPV Dの一例として、真空蒸着を用いる例を説明した。真空蒸着に代えて、スパッタリングを 使用することにより、より高感度の味覚センサを製造可能である。スパッタリングにより 形成する電極としては、上記のチタン(Ti)、クロム(Cr)、アルミニウム(A1) 、金(Au)、白金(Pt)等の金属の他、銅(Cu)、タングステン(W)、タンタル (Ta)等の電極を形成することができる。このスパッタリング、例えば、これらの材料 から形成されるターゲットに電子線を照射することにより、これらの原子を堆積すること によっても、表面粗さが小さく高品質の電極13の形成が可能である。これにより、より ー層、LB膜17との親和性に優れ、高感度(高最大膜電位と高応答速度)のセンサを大 量 生 産 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ の 例 の 場 合 も 、 電 極 1 3 の 膜 厚 は 、 1 0 n m ~ 1 0 0 μ mで、その平坦度は10nm以下であることが望ましい。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

(第3の実施の形態)

10

20

30

40

前記第1及び第2の実施の形態においては、金属電極13を製造するためにPVDを使用 する例を示したが、例えば、CVD(Chemical Vapor Depositi on)を使用することも可能である。 C V D は、タングステン(W)、タンタル(T a) 等の電極を形成する場合に優れている。このCVDによっても、従来の銀板電極に比べて 、表面粗さが小さく高品質の金属電極13の形成が可能であり、LB膜17との親和性に 優れ、高感度のセンサを製造することが可能である。この例の場合も、電極13の膜厚は 、10nm~100µmで、その平坦度は10nm以下であることが望ましい。 [0023](第4の実施の形態) 金属電極13を製造するためにMOCVD(Metal Organic Chemic 10 Vapor Deposition)を使用することも可能である。この場合も、 a l 上記のいずれの金属を形成することも可能である。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ (第5の実施の形態) 金属電極13を製造するために電気メッキを使用することも可能である。この場合、シー ド層を蒸着法を使用して形成し、このシード層に電圧を印加しつつ金属電極13形成領域 をメッキ漕に浸し、電気メッキを行う。このメッキ法により形成する電極の材料としては 、銅(Cu)、ニッケル(Ni)、銀(Ag)が優れている。 [0025](第6の実施の形態) 20 上記実施の形態においては、感応膜としてLB膜を使用する例を示したが、ポリ塩化ビニ ール(PVC)、人工脂質膜などを使用することも可能である。これらの感応膜を使用す る場合にも、感応膜を構成する分子の分子間隔と金属電極13の表面粗さとは、表面粗さ が分子間隔とほぼ等しいかより小さいことが望ましい。 [0026]【実施例】 (実施例1) 以下、この発明の第1の実施の実施の形態に基づく実施例を説明する。 まず、ガラスからなる絶縁基板11上に、真空蒸着法により、金属電極13を、引出電極 15と一体に、厚さ1µm、10mm×10mmに形成した。 30 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ 一方、膜物質として、Di Octadecyldimethyl Ammonium Bromide(以下、DOABr)を使用し、また、ポリイオンコンプレックス法で使 用する下層の高分子としてPotassium Poly-vinyl Sulfate (以下、 P V S K)を使用して、 1 0 層に堆積した L B 膜 1 7 を生成した。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ 一方、測定系としては、味覚センサ及び参照電極間に発生する電位差を測定する静止膜電 位測定法に基づき、図4に示す測定系を使用した。 まず、基準溶液(10mM KC1溶液)における膜電位差の測定を行い、次に、安定状 態(膜電位1mV/5min)に移行後、呈味物質として酸味物質である酢酸溶液(25 40 において、10mM KC1 溶液に酢酸を飽和させたもの)をシリンジなどで滴下し 、再び安定状態に移行した後、測定を終了とした。また、センサは、純水に20分間浸漬 して、これを洗浄した。センサの応答例を図5に示す。図より滴下時からのピーク値を最 大 膜 電 位 、 ピ ー ク 値 を 取 る ま で の 時 間 を 応 答 時 間 と し 、 2 つ の パ ラ メ ー タ を 使 用 し た 応 答 評価を行った。 [0029]図6に、チタン電極と金電極を用いたセンサの膜電位と応答時間と、滴下量との関係を示 す。また、比較例として、従来の厚さ1mmの銀板電極をエポキシ樹脂を用いて基板に固 定したタイプのセンサの膜電位と応答時間とを示す。 図示するように、本実施例のセンサは、金属電極の材質が、チタン電極の場合も金電極の 50

(5)

場合も、従来のセンサに対して優れた膜電位と高速応答時間を示す。特に、チタン電極は 、高い膜電位を示し、濃度に依存しない比較的高速な応答特性を示すことが確認された。 [0030](実施例2) 以下、この発明の第1の実施の実施の形態に基づく実施例を説明する。 センサの形状は、第1の実施例のセンサと同一とし、チタン(Ti)と金(Au)の金属 電 極 1 3 を 、 電 子 線 照 射 に よ る ス パ ッ タ リ ン グ に よ り 形 成 し た 。 一 方 、 L B 膜 1 7 の 構 成 は、第1の実施例と同一である。 この実施例では、金属電極13がチタンの場合も金の場合も、第1の実施例よりも、高い 最大膜電位と速い応答速度を得ることができた。 10 [0031]第1及び第2の実施例により、薄膜成長法、特に、スパッタリングによる電極形成とLB 膜との組み合わせにより、高感度で、高速応答性を有する味覚センサを得ることができる ことが確認された。 [0032]従来、味覚センサの最大膜電位については注目されていたが、応答速度についての検討は あまりなされていなかった。実用に値する応答速度は、0.5秒程度と解釈されるが、本 発明のセンサによりこの要求が充足されうることが確認された。 な お 、 こ の 発 明 は 、 上 記 実 施 の 形 態 及 び 実 施 例 に 限 定 さ れ ず 、 種 々 の 変 形 及 び 応 用 が 可 能 20 である。例えば、上記金属電極の製造方法を臭覚センサの金属電極の形成、例えば、水晶 振動子の表面電極の形成に使用することも可能である。 [0034]また、LB膜の材質なども任意であり、例えば、ポリイオンコンプレックス法で使用する 下層の高分子として、PVSKに代えて、或いは、PVSKと共にChondroiti on Sulfate A sodium Salt (Chondroitin)を使 用すること等も可能である。 [0035]【発明の効果】 この発明によれば、高感度で高速応答性を有するバイオセンサを提供できる。 30 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の実施形態に係る味覚センサの構成を示す図である。 【図2】金属電極とLB膜との関係を示す図である。 【図3】味覚センサの製造工程を説明するための図である。 【図4】測定系を説明するための図である。 【図5】応答特性の例を示す図である。 【 図 6 】 実 施 例 に 係 る セン サ の 感 度 と 応 答 速 度 を 示 す 図 で あ る 。 【図7】従来の味覚センサの構成を示す図である。 【符号の説明】 1 1 40 絶縁基板 13 金属電極 15 引出電極 17 LB膜 1 1 1 原 板 1 1 3 マスク 1 1 4 開口 1 1 5 蒸 発 源 1 1 7 ヒータ 1 1 9 チャンバ





15



(b)

【図2】

(a)





(a)













フロントページの続き			
(51) Int.CI. ⁷	FI G01N 27/30	3 3 1 C	テーマコード(参考)